

Case. SM_1

증례:

Laser를 이용한 발치 후 즉시 식립

환자의 성별 및 나이 :

남성 / 30대 중반

치료기간 :

3개월

결손부위

하악 우측 제1대구치

사용 제품

DIO SM Implant
(SFW5314)

치료계획

발치 후 Erbium laser를 이용하여 Drilling을 시행하고 즉시로 임플란트를 식립하기로 결정

총괄 및 고안

일반적인 Drill 대신에 Laser를 이용하여 Bone을 삭제함으로써 얻는 장점은 Bleeding이 덜 되고 술 후 통증이 일반적인 방법보다 감소하며 더불어 골재생의 효과가 있다는 점이다. 단점으로는 골형성 시간이 일반적인 Drilling 방식에 비하여 오래 걸린다는 것.



1. 하악 우측 제1대구치 부위의 Residual root를 제거하고 임플란트를 식립하기로 계획을 세움



2. 발치 전 Laser를 이용하여 시술 부위를 소독



3. 발치 전 Laser를 이용하여 시술 부위를 소독



4. 발치 전 Laser를 이용하여 시술 부위를 소독



5. 해당 치아를 발치함



6. 발치후의 발치와를 Laser로 소독



7. 발치후의 발치와를 Laser로 소독



8. 발치후의 발치와를 Laser로 소독



9. 발치후의 발치와를 Laser로 소독



10. 발치후의 발치와를 Laser로 소독



11. 발치후의 발치와를 Laser로 소독



12. 발치후의 발치와를 Laser로 소독



13. Laser를 이용한 Osteotomy 시행



14. Laser를 이용한 Osteotomy 시행



15. Laser를 이용한 Osteotomy 시행



16. Laser를 이용한 Osteotomy 시행



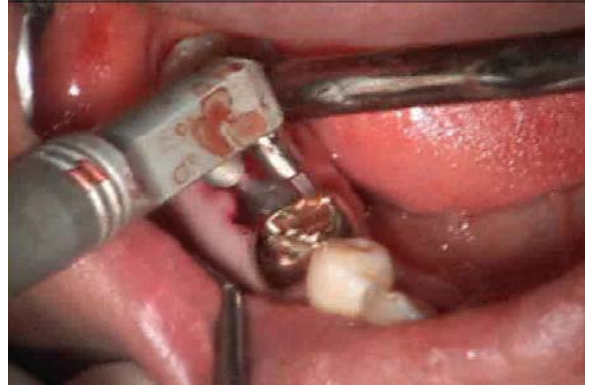
17. Laser를 이용한 Osteotomy 시행



18. Laser를 이용한 Osteotomy 시행



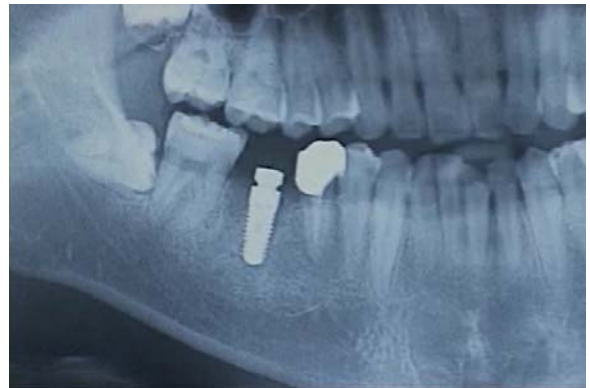
19. 5 x 12 mm SM Implant 식립하고
Healing abutment 연결



20. Implant 주위의 연조직을 Laser로
소독



21. 식립 후의 Panorama



22. 식립 후의 Panorama